投資家エンゲージメント実績	機関投資家向け説明会	対面ミーティング	メディア掲載
2026年実績	3	6	18
累計実績	3	6	18

※ データ基準日：2026年10月23日

NEMSは、定期的に機関投資家向け説明会に参加し、業績、財務状況および今後の見通しについて説明しています。また、説明会では投資家から寄せられた質問に回答するとともに、その内容を記録しています。説明会の資料および動画は、当社ウェブサイトの「IR情報」ページにて公開し、情報開示の透明性確保に努めています。2026年度の投資家向け説明会において寄せられた主な質問と、それに対する当社の回答概要は以下のとおりです。

Q1：半導体および先端パッケージング向け製品の構成比率の上昇は、当社の売上総利益率の改善につながりますか？

半導体製造工程向けのICP-RIE装置およびIC基板製造工程向けの連続式プラズマ装置は、いずれも当社の中で比較的高い売上総利益率を確保できる製品です。高性能装置の出荷比率の上昇と自動化機能の導入が進むことから、当社は来年度の全体的な売上総利益率について、慎重ながらも楽観的な見通しを持っています。

Q2：当社のドライプラズマ技術は、TGV（ガラス貫通電極）の穴あけ加工において、レーザー加工を完全に代替できますか？

現段階では、TGVの貫通孔形成には、主にレーザー加工と化学的手法を組み合わせた方法が採用されています。当社のプラズマ技術は、主に貫通孔形成後の孔壁粗化、表面改質および残渣除去に適用されます。これにより、後工程における銅めっきの密着性を向上させるとともに、ガラスのクラック発生リスクの低減を図ります。

Q3：孔径がどの程度小さくなると、プラズマ加工はレーザー穴あけ加工に対して技術的な優位性を発揮しますか？

当社が現在進めている顧客との共同開発および評価試験の経験に基づくと、孔径が約20μm以下になると、プラズマ加工の技術的な優位性が徐々に顕在化します。現在、国内大手IC基板メーカーとプロセス開発を進めており、量産効率および歩留まりの継続的な改善に取り組んでいます。

Q4：現在の生産能力および外部委託先の生産体制で、今後の受注に十分対応できますか？

現在の受注残高および来年度の受注見込みに基づくと、既存の生産能力と外部委託を組み合わせた生産体制で、当面の需要に対応できる見通しです。今後、標準装置の大口受注を獲得した場合には、提携する協力工場の生産能力を活用することで、生産能力の拡充と納期の短縮を図ります。